



2025年07月02日
株式会社サトーセン

世界初の本格的な社会実装へ！液体金属ストレッチャブル基板を アメリカ、シンガポールの国際会議で相次ぎ発表

伸縮性回路基板“ストレッチャブル基板”の製造・販売を行う株式会社サトーセン(所在地：大阪府大阪市、代表：宮原 慶太)は、開発を進めている液体金属を使用したストレッチャブル基板について、アメリカとシンガポールで開催された2つの国際会議・イベントにて招待講演を実施しました。

※世界初…当社調べ

(1) The Future of Electronics RESHAPED(アメリカ、ボストン、2025年6月11日～12日)
<https://www.techblick.com/electronicshapedusa>

(2) IEEE FLEPS 2025(シンガポール、2025年6月22日～25日)
<https://2025.ieee-fleps.org/>

■ 背景

株式会社サトーセンでは約10年前からストレッチャブル基板の開発を行っています。従来のプリント基板とは大きく異なる柔軟性や伸縮性を生かして、ヘルスケアやスポーツ向けに使用されるウェアラブルデバイスへの採用が進んでいます。

一方で、当社は更なる性能と耐久性向上のため、液体金属を回路材料に使用した新世代のストレッチャブル基板を昨年販売開始し、業界内で大きな注目を浴びています。

今回、プリントド/フレキシブルエレクトロニクス2つの国際的なカンファレンスからの招待を受け開発担当者が現地にて開発経緯や現況の講演を行いました。

■ 各カンファレンスについて

* The Future of Electronics RESHAPED

国際的なイベント開催プラットフォームTechBlickが主催するエレクトロニクス分野の国際会議&展示会。ボストンにあるマサチューセッツ大学ボストン校にて開催されました。

フレキシブル、プリントド、サステナブルといった次世代エレクトロニクスの最新技術や応用事例に焦点を当てています。

世界中の研究者や企業が集まり、未来の電子機器の形を議論し、ネットワーキングを行う重要なイベントで、北米におけるこの分野で最大かつ最も重要な会議・展示会の1つとされています。



TechBlick主催RESHAPEDでの講演(マサチューセッツ大学ボストン校にて)

* IEEE FLEPS 2025

フレキシブル・プリンタブルセンサー・システムに特化した、IEEE(電気電子学会)主催の国際会議。この会議では、柔軟な素材に印刷技術で電子回路を作る最新の研究成果や応用事例が発表されます。

世界中の研究者やエンジニアが集まり、未来のウェアラブルデバイスやIoT技術などを議論する場となり、今年度はシンガポール(シンガポール国立大学)にて開催されました。



IEEE FLEPS 2025での講演の様子(シンガポール国立大学)

■ 液体金属を使用したストレッチャブル基板の開発進捗について

両講演では、本開発の本格的な社会実装と量産化を前提とした同社のスタンスと採用実績について語りました。これまで基礎研究の分野で取り上げられることの多かった液体金属の製品化への道筋に参加者の関心も高く、特に欧米メーカーから大きい反響がありました。既に生体センシング用途で量産開始間近の製品もあり、更なる用途拡大が期待されています。

■ 会社概要

商号 : 株式会社サトーセン
代表者 : 代表取締役 宮原 慶太
所在地 : 〒557-0062 大阪府大阪市西成区津守3丁目7番27号
設立 : 平成24年2月
事業内容 : 産業用プリント基板製造
資本金 : 99,540,000円

URL : <https://www.satosen.co.jp/>

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】
株式会社サトーセン
お問い合わせフォーム : <https://www.satosen.co.jp/contact.html>

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】
株式会社サトーセン 技術開発部
担当 : 清水 良太
MAIL : r_shimizu@satosen.jp

プレスリリース画像



IEEE FLEPS 2025での講演の様子(シンガポール国立大学)



TechBlick主催RESHAPEDでの講演(マサチューセッツ大学ボストン校にて)

添付動画

TechBlick主催RESHAPEDでの講演の様(冒頭5分)
<https://www.youtube.com/embed/wiQ5DB0ExcQ>